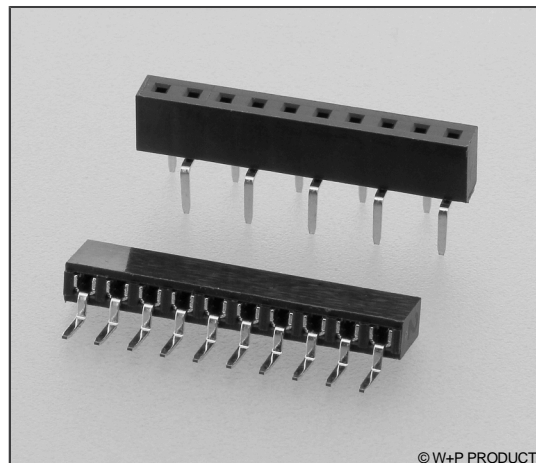


## Buchsenleisten, RM 2,00mm, gerade, 1-reihig – durchsteckbar Female Headers, 2,00mm Pitch, Straight, Single Row – Dual Entry

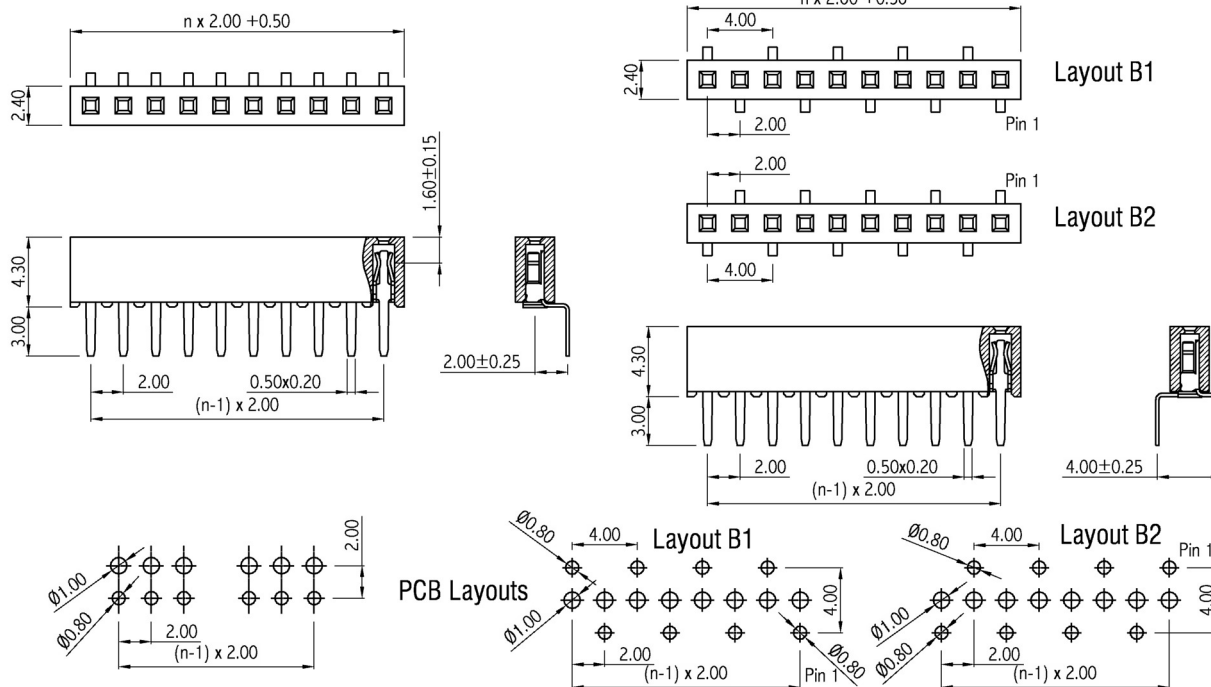
### Technische Daten / Technical Data

|  |   |
|--|---|
| Isolierkörper<br><i>Insulator</i>                    | Thermoplast, nach UL94 V-0<br><i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>  |
| Kontaktmaterial<br><i>Contact Material</i>           | Kupferlegierung<br><i>Copper alloy</i>  |
| Kontaktfläche<br><i>Contact Surface</i>              | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)<br><i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i> |
| Durchgangswiderstand<br><i>Contact Resistance</i>    | < 20 mΩ   |
| Isolationswiderstand<br><i>Insulation Resistance</i> | > 1000 MΩ   |
| Spannungsfestigkeit<br><i>Test Voltage</i>           | 500 V AC  |
| Nennstrom<br><i>Current Rating</i>                   | 1 A   |
| Temperaturbereich<br><i>Temperature Range</i>        | -40 °C ... +105 °C  |
| Verarbeitung<br><i>Processing</i>                    | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren<br><i>Wave or reflow soldering</i>   |



© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,50mm.  
*Dual beam contacts accept 0.50mm square pins.*



|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| <b>Series</b> | <b>Contacts*</b>                                     | <b>Layout*</b>   | <b>Plating*</b>  |
| <b>745</b>    | <b>010</b><br>003-040 Einreihig<br><i>Single row</i> | <b>2</b><br>1 Einseitig<br><i>Single-sided</i><br>2 Layout B1<br>3 Layout B2 | <b>60</b><br>60 Sel. Au/Sn<br><i>Duplex plating</i><br>80 Sel. Au 30µ\ / Sn (Option) |

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

# Informationen zum Wellen-Lötverfahren

## Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert      |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150 °C        |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200 °C        |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60 – 180s     |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | 217 °C        |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | 60 – 180s     |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$               | 260±5 °C      |
| Dauer Höchsttemperatur               | 20 – 40s      |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s      |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$ | max. 8m       |

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values    |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150 °C        |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200 °C        |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60 – 180s     |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | 217 °C        |
| Duration above $T_L$                 | 60 – 180s     |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature $T_P$               | 260±5 °C      |
| Duration Peak Temperature            | 20 – 40s      |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s      |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | max. 8min     |

